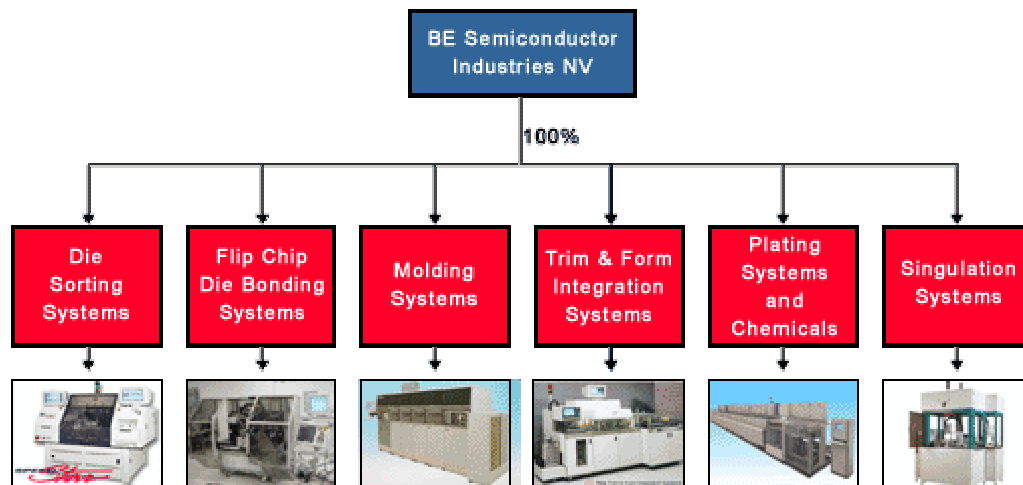


# BESI: kleine speler maar verrassend sterk

27 oktober2002 - Jo Swaen

BE Semiconductor Industries N.V. is een vooraanstaand producent van machines voor de verschillende stappen in het assemblageproces van halfgeleiders. De verschillende stappen waarvoor BESI machines levert zijn het verpakken oftewel 'packaging', het selecteren oftewel 'die sort', het monteren van halfgeleiders op een contactvlak oftewel flip-chip 'die attach' en ook het middels een elektrolytisch proces aanbrengen van een contactlaag oftewel 'platen'.



## De halfgeleider industrie

Halfgeleiders zijn de bouwstenen voor elektronische producten en systemen. Halfgeleiders werden in het verleden hoofdzakelijk als standaardcomponenten in grote volumes geproduceerd. Steeds meer toepassingen kunnen op één chip ontwikkeld worden. De snelle ontwikkeling van geavanceerde halfgeleider-toepassingen dwingt fabrikanten hun kerntechnologie, waartoe packaging behoort, en productieprocessen voortdurend te verbeteren om concurrerend te kunnen blijven.

## PRODUCTEN

BESI ontwikkelt en produceert halfgeleider packaging-, plating-, chip montage en chip sorteer machines.

Dit zijn met name:

- o geautomatiseerde molding machines, die de gemonteerde chips met kunsthars omhullen;
- o geautomatiseerde snij- en buigmachines, die de metalen contactpootjes van de verpakte chip snijden en buigen;

o geautomatiseerde precisie zaagmachines, die de verpakte chip - als deze op substraatmateriaal gemonteerd is - in enkelvoudige producten zaagt.

BESI's plating machines brengen zeer dunne, eventueel verschillende, laagjes metaal aan en bestaan uit volautomatische processtraten met een lengte variërend van 20 tot 60 meter.

\* Flip-chip die attach montage systemen monteren chips op substraten en zijn zowel handmatig als geautomatiseerd te bedienen en plaatsen de contactpunten van de chip direct op de contactpunten van een substraat. Geautomatiseerde chip sorteer machines worden toegepast voor het inspecteren,

selecteren en sorteren van chips, flip-chip componenten en verpakte chips op wafers. In 2001 heeft BESI een nieuw assemblageconcept, ABC, geïntroduceerd, die processtappen op procesniveau integreert met zowel producten van BESI origine als die van andere fabrikanten.

## **Back-end assembly machines**

### GEAUTOMATISEERDE VERPAKKINGS- I.E. MOLDING MACHINES

Als chips eenmaal zijn gemonteerd op een contactdrager dienen ze in een stabiele, neutrale behuizing te worden verpakt. BESI produceert automatiseerde molding machines voor toepassing bij zowel conventionele verpakkingstechnologie als verpakkingen gebaseerd op substraattechnologie, waarbij chips in kunstharz worden verpakt. Een verdere toename van het aantal verpakkingsoorten zal leiden tot een toename van ontwikkelingen voor geavanceerde geautomatiseerde moldingprocessen.

### GEAUTOMATISEERDE SNIJ- EN BUIGMACHINES

Met deze machines worden de metalen pootjes van verpakte chips gesneden en gebogen ter voorbereiding van het monteren op printplaten of in een andere toepassing. Snijden en buigen is de laatste processtap van de fabricage van halfgeleiders en vereist een hoge mate van precisie.

### GEAUTOMATISEERDE PRECISIE ZAAGMACHINES

Zagen is de laatste processtap van de fabricage van halfgeleiders op substraatbasis, waarbij een reeks verpakte chips in enkele producten gezaagd wordt.

## **Plating machines**

### GEAUTOMATISEERDE PLATING MACHINES

Een essentiële processtap voor chip back-end assembly vormt het aanbrengen van een geleidend laagje, bestaande uit zilver of goud voordat de chip gemonteerd kan worden. Eenmaal verpakt worden de pootjes vertind, tevens middels een platingproces, om de chip te kunnen verbinden met andere onderdelen.

### GEAUTOMATISEERDE BALL PLACEMENT MACHINES

Om van de verwachte verdere groei van de op substraattechnologie gebaseerde chip montage te kunnen profiteren, ontwikkelt BESI een nieuwe ball placementmachine.

### FLIP-CHIP DIE ATTACH MONTAGE MACHINES

Flip-chip montage technologie kan de huidige fijne draad montage technologie deels vervangen, door de contactpunten op de chip direct op de contactpunten op het substraat te plaatsen. De flip-chip montage technologie maakt een verdere miniaturisatie mogelijk.

## **PROCESINTEGRATIE OPLOSSINGEN**

BESI heeft in 2001 een nieuw assemblageconcept geïntroduceerd onder de productnaam ABC, welke het mogelijk maakt processtappen - vervaardigd door dochterondernemingen en vervaardigd door anderen - te clusteren i.e. te combineren. Het ABC-systeem beoogt op termijn alle assemblage processtappen te integreren, van zowel de huidige montage technologie als de toekomstige montage technologieën.

BESI opereert vanuit vier 100% dochterondernemingen met elk een specifieke product focus. Fico produceert packaging machines, Meco produceert electro plating machines en precisie zaagmachines, RD Automation produceert flip-chip die attach machines en Laurier (in januari 2002 verworven) produceert chip sorteer machines. BESI heeft een geavanceerde assemblagemachine ontwikkeld op basis van 'geclusterde' processen, genaamd ABC (Advanced Back-end Cluster). De ABC integreert zowel producten van BESI-dochterondernemingen als producten van andere leveranciers, met als doel een compleet assemblageproces te leveren.

BESI's klanten zijn de toonaangevende fabrikanten van halfgeleiders en assemblagediensten in de Verenigde Staten, Europa en Azië. De apparatuur wordt specifiek gebruikt voor halfgeleidermontage en vormt bij veel klanten een aanzienlijk percentage van hun totaal geïnstalleerde machinepark. BESI is in mei 1995 ontstaan uit het samenvoegen van Fico en Meco en is sinds december 1995

beursgenoteerd. BESI's aandelen staan genoteerd op Nasdaq en op Euronext Amsterdam

De belangrijkste gebeurtenissen voor BESI in 2001:

- o Verkoop van het 30% belang in PBE ( Possehl Besi Electronics). PBE was voor BESI niet strategisch. De opbrengst van de verkoop ( € 18,1 milj.) zal worden aangewend voor mogelijke acquisities.
  - o Een verlaging van het aantal vaste personeelsleden door een tweetal herstructureringen waardoor de overhead met € 7 milj. werd verlaagd. De herstructureringskosten bedroegen in totaal € 8,3 milj. (€ 5,5 milj. na belasting)
  - o Introductie van de ABC, die meerdere halfgeleider assemblagestappen in één enkele machine integreert
  - . o Een verhoging van de liquiditeitspositie door zowel een positieve operationele kasstroom als de verkoop van het PBE belang.
- \* BESI houdt de productie op hogere niveau's (vergelijkbaar met 2000) zodat men onmiddellijk kan reageren op een komende marktopleving. Dit doet men door een fabriek te openen in China en door in Duiven een nieuwe faciliteit te bouwen voor molding en tooling welke operationeel wordt in Q2 2003
- o De aankoop van Laurier Inc. op 4 januari 2002, een volgende stap voor de verdere integratie van het assemblageproces. Laurier voegt aan BESI chip sorteer technologie toe, een vergroting van de bestaande klantenkring en een versterking van de marktpositie in de Verenigde Staten.

Gegevens van BESI sinds 2000

Tabel 1

BESI jaar	kwartaal	omzet	winst/ verlies	bijdrage PBE winst/verlies	p/a	%gross margin%	share equity	tot liab sha/equit	Cash	back- log	inven- tories	
2000	1q	37,8	2,3		0,6	0,09	35,1	137,8	203,773	52,7	109,1	29,637
2000	2q	44,3	5,7		1,4	0,2	37,6	236,9	302,98	134,9	120,8	34,196
2000	3q	53,8	8,9		1,8	0,28	40	242,5	316,68	122,6	145,5	35,403
2000	4q	62,1	8,7		1,2	0,27	40,8	247,7	325,747	122,8	141,7	39,766
2001	1q	54	5,1		-0,6	0,16	39,2	256,1	333,187	120,3	109,4	45,346
2001	2q	45,6	-0,7	restructering	-1,8	-0,02	38,4	252,5	316,281	115	74,7	43,908
2001	3q	31,5	-2,8	restructering	-2,6	-0,09	36,9	245,1	295,443	121	47,5	36,275
2001	4q	18,9	-13,5	restruct.PBE	-7,1	-0,42	18,5	228,3	271,886	141,5	36,5	29,31
2002	1q	14,5	-4,1			-0,13	23,6	224,6	268,803	128,7	38,2	30,901
2002	2q	19,2	-2,1			-0,07	31,2	218,2	261,309	128,4	46,1	30,797
2002	3q	22,4	-1,7			-0,05	32,9	212,5	255,851	114,3	44,9	33,87
2002	4q											

Uit het overzicht blijkt dat BESI goed profiteerde van het semiconductor recordjaar 2000. Maar ook BESI kon zich blijkbaar ook niet onttrekken aan de neergang in de industrie na het recordjaar. BESI anticepeerde daarop door herstructureringen door te voeren en PBE te verkopen. Vanaf begin 2002 leiden deze maatregelen tot aantoonbare resultaten. Echter hoewel een bodem gevormd lijkt te zijn en het verlies per aandeel terugloopt is er nog steeds sprake van verlies. Een positieve ontwikkeling is de stijging te noemen van de gross margin van een dieptepunt van 18,5% in 4q 2001 naar 32,9% in het 3q 2002.

De aankoop van RD Automation heeft ertoe geleid dat de omzet in Flip Chip Die Attach Systemen toenam van 1% van de omzet in 2000 tot 5% in 2001. Belangrijk omdat de marge hierop groter is.

Afnemers van RDA zijn: Lucent Technologies, JDS Uniphase, Samsung, Corning, Blaze Technologies, Nanovation, HP, Micron Technology, Nokia, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin en Grumman. Besi werd door de aankoop van RD Automation in één klap wereldmarktleider van de Die Bonding techniek.

De aankoop van Laurier Inc. past in de strategie van BESl om klanten geautomatiseerde , geïntegreerde procesoplossingen met optimale flexibiliteit te bieden, waarbij het van belang is nieuwe technologieën en processen te ontwikkelen in nieuwe machines. Hierdoor wordt ook BESl's positie verder versterkt.

Dat brengt ons bij de financiële positie van BESl: zie tabel 2

BESl jaar	q	operat income	interest income	net income	p/a	aandelen	shareh equity	p/a €	Cash	p/a €	tot liab sha/equi	p/a €
2000	1q	2,531	-20	2,295	0,09	26,557,551	137,8	5,19	52,7	1,98	203,773	7,67
2000	2q	4,891	744	5,676	0,18	30,906,012	236,9	7,67	134,9	4,36	302,98	9,8
2000	3q	1,677	921	1,817	0,06	31,894,721	242,5	7,6	122,6	3,84	316,68	9,93
2000	4q	11,188	1,169	8,679	0,27	31,823,046	247,7	7,78	122,8	3,86	325,747	10,24
2001	1q	7,633	1,136	5,092	0,16	31,810,621	256,1	8,05	120,3	3,78	333,187	10,47
2001	2q	-431	1,051	-5,805	-0,18	31,794,675	252,5	7,94	115	3,62	316,281	9,95
2001	3q	-1,128	1,118	-2,767	-0,09	31,794,675	245,1	7,71	121	3,81	295,443	9,29
2001	4q	-10,46	935	-13,498	-0,42	31,794,675	228,3	7,18	141,5	4,45	271,886	8,55
2002	1q	-6,577	939	-4,061	-0,13	31,794,675	224,6	7,06	128,7	4,05	268,803	8,45
2002	2q	-4,018	844	-2,098	-0,07	31,494,675	218,2	6,93	128,4	4,08	261,309	8,3
2002	3q	-3,349	837	-1,654	-0,05	31,330,660	212,5	6,78	114,3	3,65	255,85	8,17
2002	4q											

Het verliesgevende net income was inclusief herstructurering € 0,94 per aandeel sinds 2q 2001. Exclusief herstructureringskosten was het verliesgevende net income € 0,46 per aandeel sinds 3q 2001.

Een vergelijking van ASMI met BESl sinds het 3q 2001 geeft het volgende overzicht.

Tabel 3

		ASMI	BESl
2001	3q	-0,26	-0,05
2001	4q	-0,18	-0,16
2002	1q	-0,25	-0,13
2002	2q	-0,13	-0,07
2002	3q	-0,09	-0,05
totaal		-0,91	-0,46

Voor beide bedrijven geldt dat het verlies terugloopt, waaruit toch blijkt dat men en de kosten in de hand heeft en de industrie langzaam uit het dal komt.

Nog enkele afsluitende opmerkingen over BESl:

Nog enkele afsluitende opmerkingen over BESl:

- 1) BESl verklaarde bij de cijfers over het 3 q 2002: "Current economic uncertainties make forecasting results for future periods extremely difficult, but we believe that our latest product

generations and efforts to reduce operating costs leave us well positioned for any industry recovery."

2) BESI verklaarde bij de cijfers over het 3 q 2002: In the third quarter of 2002, we relocated our flip chip die attach operations from New Jersey to New Hampshire in the United States, and consolidated our die sorting business into a single business unit, called Die Handling Systems. We recorded a one-time charge for this relocation of € 0.4 million.

3) BESI heeft een solvabiliteit van zo'n 84%. Dat is fors te noemen. Uit het overzicht van tabel 2 blijkt dat de interest inkomsten teruglopen. Vraag is natuurlijk wanneer BESI dat gaat aanwenden voor verdere acquisities.

4) In ieder geval gebruikt men het kapitaal om ook het aangekondigde aandelen inkoopprogramma verder te effectueren. Inmiddels heeft men 811,295 aandelen ingekocht voor een gemiddelde prijs van € 5,53. Men koopt nog 188,705 aandelen in.

5) Bij een koers van het aandeel van rond de € 4,75 noteert het aandeel € 2,03 onder total shareholders' equity. Het aandeel noteert zelfs € 3,42 onder de € 8,17 de total liabilities and shareholders' equity.

6) Een en ander houdt in dat het aandeel voor een belegger een zeer goede investering is en het aandeel is dan ook koopwaardig.

7) De industrie heeft nog steeds te maken met moeilijke marktomstandigheden. Ook BESI onttrekt zich daar niet aan. Maar bij een koers van BESI van ongeveer € 4,75 is het aandeel heel goedkoop en ondergewaardeerd. Het is niet overdreven te stellen dat een koersdoel van rond de € 10, zeker bij een aantrekkende markt voor BESI haalbaar moet zijn. Voor mensen met enig geduld is een rendement van zo'n 100% mogelijk.

8) Gelukkig is BESI, door de stichting continuïteit BESI, gewapend tegen een vijandige overname. Gezien de eigenlijke waarde van het bedrijf zouden er wel eens kapers op de kust kunnen komen. Als die dan genoeg betalen voor een aandeel zal niemand daar bezwaar tegen hebben.

9) Zou BESI eigenlijk gezien de omvang van het bedrijf niet beter met b.v. ESEC kunnen gaan praten over een overname? Want het blijft een kleine speler.

10) Het management van BESI dient meer openheid van zaken te geven ten aanzien van mogelijkheden van acquisities.

11) BESI hoort ervoor te zorgen dat de SEC documenten, zonder aanvraag bij BESI, geraadpleegd kunnen worden. Ik doel hier vooral op Form 20F en Form 6K de andere bij de SEC gedeponeerde documenten.

12) Uit de conference call:

a) Van de bestede cash bestond € 700,000 uit afschrijving inventories;

b) € 4 miljoen werd besteed voor de aankoop van aandelen voor het incentive plan;

c) De fabriek in China zal van 2q 2003 in productie zijn.

d) De fabriek in Duiven 4 q 2003, at lower cost

e) Break even resultaat kan worden behaald bij een omzet van € 100 miljoen afhankelijk van produkten verkoop( tooling). Indien meer molding dan omzet break even bij € 110 miljoen.

f) BESI heeft 12 nieuwe customers; clear interest from major customers; set up demo-line end quarter

g) Next year: Visibility is very short; but our backlog and orders are good. We have our cost under control, if times changes we can take part of it.. But even when the market not have an upturn the common months we can handle it.

h) We are preparing additional acquisitions with our cash next year.

i) Gross Margin 4q may be 1% higher

j) Shipments 1 q 2003 on track

k) Verwachte omzet hoger dan € 22,4 miljoen dan q 3, door de toename van de backlog

l) Resultaten onder de streep zullen verbeteren dit komt door verbetering werkkapitaal.

BE SEMICONDUCTOR is dus een kleine speler maar verrassend sterk.

Naschrift redactie: naar aanleiding van deze column heeft Hans Jager een aantal vragen gesteld in het ASMI forum, bijgaand de antwoorden van Jo.

1. Wat is "Die Bonding techniek" waarin Besi marktleider is na acquisitie van RD Automation (ben nog een leek op dat gebied).

Antwoord:

Flip Chip Die Attach Systems

Flip chip technology eliminates the need for conventional wire bonding by placing the contact points of the chip in direct contact with the packaged substrate.

The use of flip chip bonding technology is critical for the needs of chip manufacturers to further shrink device sizes while increasing functionality for applications such as wireless telephony, personal digital assistants, consumer electronics and Internet infrastructure. Our die attach equipment offers a variety of bonders with its product line. The automatic systems offer solutions for process development and volume production applications, including models catering to 1 micrometer accuracy bonding. In addition, we offer semi-automatic systems capable of bonding from 10 g to 125 kg of force, with an average placement accuracies of approximately 2 micrometers. In the opto-electronics field, the precision die bonders are critical in the assembly of filters such as waveguides which optimize the flow of data in fiber optic networks.

En verder uit interview met dhr Blickman in Beursplein 5 nr. 12 2001:” De techniek die RD Automation toepast is belangrijk als mobile telefonie naar een grotere bandbreedte gaat. Op een bepaald niveau kun je namelijk de chips niet meer met draadjes verbinden, maar moet je ze rechtstreeks op het substraat monteren”.

2. Solvabiliteit van 84% extreem hoog. Op eerste gezicht positief uiteraard, echter wat is strategie hierachter? Als die niet zichtbaar wordt ontstaat meestal snel de roep om het overtollige geld maar aan aandeelhouders terug te geven.

Antwoord: `Tijdens de conference call is daar ook een vraag over gesteld. Namelijk: Besi has a comfortable position in Cash. Antwoord van dhr Blickman was : Whe mentioned earlier that we actively working on targets. We are looking on additional acquisitions. Dus met andere woorden men wil het geld besteden aan aquisities. Dit blijkt ook uit een interview dat gepubliceerd werd in Beursplein 5 nummer 12 van 24-31 maart 2001. In dit interview geeft dhr Blickman het volgende Statement:” Naast de kennis en middelen die je nodig hebt om bij te blijven in de huidige technologie, moeten we ook investeren in de nieuwe ontwikkelingen. Dat hebben we gedaan met de aquisities van RD Automation. De komende vijf jaar zullen we stap voor stap onze posities in deze nieuwe markt opbouwen. En dat kunnen we doen dankzij onze sterke markt- en cashpositie.

De vraag of het geld niet beter terug gegeven kan worden aan aandeelhouders is al eens eerder gesteld. Uit het hierboven gegeven antwoord wordt duidelijk dat BESI dat niet van plan is.

3. Door jouw verwacht rendement van 100% vraagt waarschijnlijk een lange beleggingshorizon. In dat kader is volatiliteit van het aandeel belangrijk gegeven. Hoe verhoudt deze zich tot sectorgenoten als ASML en ASMI?

Antwoord: De volatiliteit van BESI is kleiner dan van ASMI en ASML, dat laat onverlet dat gezien de cyclische markt waarin ook BESI werkzaam is, de koersen nog flink op en neer kunnen gaan. Voorbeeld de laatste twee dagen is zowel ASMI als ASML met zo'n 13% in waarde gedaald. BESI echter maar met 4%. Door de cyclische markt kan het bij marktherstel wel snel gaan met de opwaartse koers potentie.

4. Besi is mijns inziens een te kleine speler om op lange termijn zelfstandig te blijven. Wat is jouw visie t.a.v. consolidatiemogelijkheden in deze sector en de kansen / bedreigingen voor Besi aandeelhouders hierbij.

Antwoord: Mijn visie is dat kleinere semiconductor equipment bedrijven beter kunnen samenwerken dan elkaar beconcurreren. Ik denk dan vooral aan de kosten van research and development. Van de andere kant is de balans van BESI ijersterk en is er de Stichting Continuïteit BESI waardoor bedreigingen kunnen worden afgewend:

In April 2000, the foundation “Stichting Continuïteit BE Semiconductor Industries” was established.

The board of the foundation consists of five members, four of whom shall be independent of BE Semiconductor Industries N.V. and one of whom shall be a member of its Supervisory Board. The purpose of the foundation is to safeguard the interests of the Company, the enterprise connected therewith and all the parties having an interest there in and to exclude as much as possible influences which could threaten, among other things

By agreement which the Company entered into in April 2000 between the company and the foundation, the foundation has been granted a call option pursuant to which it may purchase a number of preference shares up to a maximum of 55,000,000 shares. Until the call option is exercised by the foundation, it can be revoked by the Company, with immediate effect. However, the Company will not be entitled to revoke the call option within three years after the execution of the option agreement.

5. Wat is outlook t.a.v. book-to-bill voor komende maanden?

Antwoord: In de conference call werd gesteld dat de komende drie maanden de "visibility is very short, difficult". Maar de book to bill was 0,95 over het derde kwartaal van 2002 vergeleken met 0,14 in het derde kwartaal 2001. Kijken we naar b.v ESEC dan heeft ESEC maar een book to bill in het derde kwartaal 2002 van 0,6. BESI doet het dus beter.

6. Orderintake Q3 viel mij tegen. Daalde van 27,1 mio in Q2 naar 21,2 mio. Ook orderportefeuille is op kwartaalbasis gedaald. Hoe kijk jij hier tegen aan?

Antwoord: De orderportefeuille is per 30 september 2002 afgenomen met 2,6% tot € 44,9 mio, vergeleken met € 46,1 mio per eind juni 2002. Ten opzichte van 31 december 2001 is de backlog gestegen met 23%.

Kijken we echter naar de orderportefeuille van b.v. ESEC dan is deze bij ESEC gedaald van zwf 62 mio in het 2q 2002 naar zwf 30 mio in het 3q 2002, een afname van meer dan 50% t.o.v. het vorige kwartaal terwijl BESI maar een achteruitgang liet zien t.o.v. het tweede kwartaal van 21.8%.

Ook hier ziet het er voor BESI gunstiger uit.

7. Volgens ABN Amro heeft grote klant van Besi aangekondigd het investeringsniveau komende maanden te verlagen. Weet jij welke dat is en het belang hiervan?

Antwoord: het is gissen natuurlijk welke klant hier wordt bedoeld: Uit de SEC file 20F geeft BESI aan dat dit hun grote klanten zijn:

Agere, Amkor, ASE, AVE, Conexant, IBM, Infineon Technologies, Lucent, Motorola, NSEB, ON Semicond., Philips and STMicroelectronics.

Algemeen is de tendens om de investeringen terug te schroeven, Zie Intel b.v. Maar alle bedrijven in de equipment sector hebben daar last van en BESI natuurlijk ook.

Feit is wel dat Dhr Blickman tijdens de conference call aangaf dat van de back log 55% tot 60% zou worden verscheept

8. Een aantal analisten verwacht een break-even resultaat in de loop van 2003. Wat is de analistenconsensus en jouw opinie?

Antwoord: Ik denk dat in de loop van 2003 het break-even resultaat zal worden bereikt. Maar is zoals ik al in mijn column aangaf afhankelijk van productmix. Wat de analistenconsensus is weet ik niet.

Wel deelde dhr Blickman tijdens conference call mee dat men de kosten onder controle had en goede margins bereikte, "even if the market wil be .... "

9. Nieuw product ABC (Advanced Back-end cluster) lijkt veelbelovend. Heeft Besi ook concrete mededelingen gedaan over verkoopaantallen of marktaandeel?

Antwoord: Nee, en ik ben druk doende van BESI daar meer duidelijkheid over te verkrijgen middels mailverkeer. Maar men verstrekt niet zo makkelijk gegevens.

10. Persoonlijk vind ik de kwaliteit van het management zeer belangrijk. Voor mij bij Besi nog een onbeschreven blad. Mening van analisten/beleggers?

Antwoord: Daar is weinig over bekend. Ik ben dan ook benieuwd bijvoorbeeld hoe dhr. Blickman zal reageren op door mij verzochte informatie, als hij van een buitenlandse reis terug is. Het valt mij in ieder geval op dat transparantie naar aandeelhouders toe m.b.t. verstrekken cijfers nog tot overleg intern leidt. Men is dat blijkbaar niet gewend. Blickman komt ook van ASMI, hoorde ik op een AVA van ASMI van Arthur del Prado